

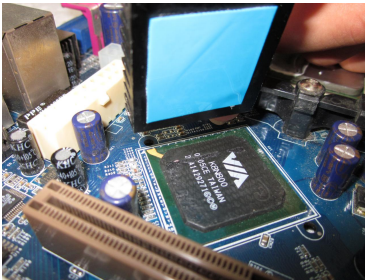
导热硅胶片 Thermal Pad

【产品概述】

SF 800 导热硅胶片很柔软，很好压缩，用于填充两个物品的界面，使得界面的空气排出，提高导热效率。该产品有自粘性，可以模切成各种形状，容易装配。导热系数有 8.0W/M-K

SF 800 thermal pad are used for filling the two contact surfaces. They are ultra soft and have good resilience, so effectively exclude air from the contact interface. The products are naturally tacky, can be die-cut into various shapes, easy to operate. The thermal conductivity can reach 8.0w/m-k.

【产品图示】



参数 SF800		
颜色/Color	灰色/Gray	目视/visual
厚度/Thickness	0.5 - 5.0mm	ASTM D374
密度/Specific Gravity	3.40g/cc	ASTM D792
导热率/Thermal Conductivity	8.0 W/m-K	ASTM D5470
邵氏硬度 (Shore 00)	50~80±5°	ASTM D2240
伸长率%/Elongation	15%	ASTM D412
拉伸强度/Tensile Strength	10psi	ASTM D412
抗电强度/Electrical Strength	>200VAC/mil	ASTM D149
UL 防火等级/UL Flammability Rating	UL94 V-0	E355606
体积电阻率/Volume resistivity	1*10 ¹³ Ω.cm	ASTM D257
适用温度/Operating Temperature	-50- 200°C	——
热阻/Thermal Resistance (1mm, @40psi)	0.29°C*in ² /W	ASTM D5470
压缩率/Compression Ratio(1mm, @40psi)	15%	——
介电常数/Dielectric Constant MHz	5.5	ASTM D150
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试工具 记录值包括界面热阻 数值仅供参考。实际应用性能到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。注：厚度公差：±10%，硬度公差：±5°，颜色/厚度/硬度均可按顾客需求测试。

【特点与优势/Features And Benefits】

- 较高的热导率 High thermal conductivity
- 阻燃性优异 Excellent flame retardant
- 电绝缘性能良 Good electrical insulation performance
- 柔韧性好、压缩率高 Good flexibility and high compression ratio

【产品规格 Configurations Available】

片状产品：200*400mm 或依照顾客要求 模切产品：依照顾客要求

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 本产品有效期为 24 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

【典型应用/Applications】

- 半导体散热装置 Semiconductor heat sink
- 车载导航仪 Vehicle navigator
- 通讯&电源设备 Communication & power equipment
- 显卡、记忆存储模块 Graphics card, memory module
- LED 照明设备 LED lighting equipment
- LCD 和等离子电视 LCD and plasma TV

